

证券代码：600460

公司简称：士兰微

杭州士兰微电子股份有限公司
投资者关系活动记录表

编号：20251125

投资者关系 活动类别	业绩说明会
活动主题	士兰微 2025 年第三季度业绩说明会
时间	2025 年 11 月 25 日 14:00-15:00
地点/方式	上证路演中心 https://roadshow.sseinfo.com 网络文字互动
参会人员	董事长：陈向东 副董事长、总经理：郑少波 独立董事：张洪胜 董事会秘书、财务负责人：陈越
投资者关系 活动主要内 容介绍	<p style="text-align: center;">投资者关系活动主要内容</p> <p>问题 1：在汽车功率控制模块开发上，有没有合作的汽车厂商？ 回答：有很多的厂商，包括国内外的。</p> <p>问题 2：厦门《12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目之投资合作协议》议案马上要进行投票实施，是否意味共计 200 亿的投资，公司会像以前一样，进行特定对象定增，进一步增加股本，摊薄每股收益。如果不进行定增，请问陈总怎么规划和筹措项目资金的落实？ 回答：《士兰 12 英寸高端模拟集成电路芯片制造生产线项目》是分两期建设，第一期总投资 100 亿元，公司出资金额为 15.1 亿元，具体可以见公司相关公告。</p> <p>问题 3：现在 AI 正在高歌猛进，新一轮的科技革命，公司在 AI 服务器电源领域芯片有没有发力，与国内外大厂合作做大做强？</p>

	<p>回答：士兰微电子在功率半导体等多个领域做得不错。同时，三年多前开始，我们重点发展模拟电路和 MEMS 传感器。</p> <p>模拟电路当前我们重点瞄准三个方向：汽车模拟电路、AI 服务器上的电源相关的模拟电路、人形机器人上的电机驱动电路。</p> <p>士兰微经过数年的研发积累和技术攻关，已经成功开发出应用于算力服务器的多款电源套片，包括：（1）16 相和 12 相 VRM 多相电源控制器；（2）90A/70A Dr.MOS；（3）12V 60A efuse；（4）12A/20A PoL 电源等。部分产品性能已经达到国际领先水平。目前 Dr.MOS 和 PoL 已经在客户端实现量产；efuse 已经通过大客户的测试和平台验证，近期将会试产；VRM 多相电源控制器正在给客户送样，预计 2026 年可以实现量产。——我们称为 AI 模拟四剑客，一起登场了。</p> <p>此外，基于 AI 应用的 48V efuse 及多款 Dr.MOS 和控制器芯片都在开发中，将在不久的未来推向市场。</p> <p>问题 4：长期持有公司股票体验感很差，能否采取有效措施，使股价回升至与行业地位匹配，增加投资信心？</p> <p>回答：非常抱歉，但也非常感谢您的支持！还是希望投资者能够看懂士兰。</p> <p>当前效益不好，主要是我们所在的新能源汽车行业价格太卷，持续的降价。再有就是我们在其他技术与产品领域的投入很大——这一点我们认为是该去做的。</p> <p>公司是国内唯一的一家以 IDM 模式运行的较大规模的厂家。需要投资者对士兰微电子有更深入的了解。</p> <p>我们在自己努力到的产品与技术方向上应该事都做的不错，大型白电、汽车功率模块、汽车级 MOSFET 单管、MEMS 惯性传感器等都有很高的占有率，市场份额国内领先。</p> <p>近日，已推出 AI 算力电源上的四颗关键模拟芯片，这在国内绝对非常领先，大家可以交流和了解，非常值得期待。</p>
--	---

	<p>另外，多个汽车级模拟电路的工艺平台已在 12 吋产线完成开发，已有多个产品推向市场，接下来的一段时间大家可以期待我们会丰富产品，全品类开发汽车级模拟电路。</p> <p>在汽车级的模拟电路工艺平台上，顺手就将完成机器人的全套电路。</p> <p>大家还会看到我们在 MEMS 产品领域的多品类进展。</p> <p>总之：一旦 IDM 公司具备了电路工艺平台的能力，叠加我们的芯片设计能力，竞争优势是非常明显的。</p> <p>问题 5：以前讲过，2026 年是 SiC 的大年，下游应用场景的增加，特别现在的新能源汽车主驱模块以及 AI 智能工厂英伟达与意法合作开发 800V 高压直流数据中心电源技术，这些都增加 SiC 芯片的需求量增加，但是三安和意法合作投资的 8 吋 SiC 重庆工厂投产，以及华润微的 8 吋 SiC 线也是产能满载，国外的东芝、罗姆以及安森美这些大厂也看到了 SiC 这个增量的市场大蛋糕，各自工厂的产能都会在 26 年大爆发，会不会导致 SiC 这个蓝海市场变成红海市场，竞争加剧，导致相关 SiC 产品的价格下行？叠加新建产线的大量折旧，拖累整体的盈利能力。又陷入增收不增利的怪圈？还有大基金一期已经进入回收阶段，大基金一期的有序退出，公司有没有相关的安排？比如公司回购大基金一期股份或者大基金一期股份通过大宗交易进行机构接力持有，如果通过二级市场减持，不利于股价的维持？这个大基金的减持就像悬在头上的达摩克利斯之剑，不知道什么时候落下来？</p> <p>回答：SiC 的性能与产能当前士兰微有明显的优势。</p> <p>问题 6：请问陈总，在平台知道，国家大基金一期在士兰集昕和集华投资的股份全部转让？为什么不公告？</p> <p>回答：您好，根据交易规则尚未达到需单独披露的要求，谢谢！</p>
--	--

	<p>问题 7：士兰微的产品有意向打入美国市场吗？ 回答：士兰微产品直接销往美国市场的占比很小。</p> <p>问题 8：士兰微为什么没有考虑在马来西亚或者泰国建生产基地？ 回答：有在思考，现阶段暂时没有压力。但在海外量产的功率模块的外形优选上已在做工作。</p> <p>问题 9：当前功率半导体价格持续低迷，公司依然在逆势扩张，这给公司的财报和股价带来了一定压力，而市场并未对激进扩张给予积极反应，请问公司对未来行业的库存和价格走势怎么看，是否会应为扩张导致周期无限期延后？ 回答：目前功率半导体行业是存在一定程度的产能扩张导致的价格承压。士兰微在全力通过技术平台升级和产品创新定义，努力做到销售规模持续增长和企业盈利的平衡。</p> <p>问题 10：AI+现在方兴未艾，士兰微是否也在管理上使用了相关产品，对期间费用有什么影响，什么数量级的影响？ 回答：我们也在机制化的推进 AI 在公司各领域的应用，但目前对公司期间费用的影响还少有体现。</p> <p>问题 11：公司代表国内功率半导体自主化的最先进水平，麻烦介绍下公司最新一代 IGBT 技术和国际先进水平之间的差距，以及国产替代的进展，谢谢！ 回答：针对车规级的 750V 和 1200V 的 IGBT，我们当前的水平与国际大厂水平完全持平，甚至略领先一点。</p> <p>问题 12：目前上游 SIC 衬底供应商积极研发和产出 12 吋的 SIC 衬底，咱们公司 25 年第四季度才大通线的 8 吋 SIC 产线是否会有产品价格成本这方面的压力，目前英飞凌的 12 吋 SIC 线也开始布</p>
--	---

	<p>局的生产，会不会因为 12 吋相对 8 吋有价格成本上的优势，咱们导致 SiC8 吋线的盈利能力收到影响？</p> <p>回答：目前 8 吋 SiC 衬底（加外延）的单位面积成本还是略高于 6 吋，预计 26 年下半年会降下来。12 吋的 SiC 目前看还稍远一点，但我们已经想到了这一点，在厦门基地上很容易升级。</p> <p>问题 13：有消息说公司 IGBT 通过特斯拉认证，并获得订单，是否属实？公司目前 8 吋碳化硅试线是否顺利？</p> <p>回答：有关与具体公司的合作现在暂不宜多说。公司 8 吋碳化硅线跑片顺利，已跑出合格芯片。计划明年年初安排通线仪式。另外，6 吋 SiC 产线负荷已大幅度上升。8 吋初步通线对我们来说应该是非常不错的时间点。</p> <p>问题 14：请问陈董事长，当初根据和厦门半导体的投资协议，什么时候可以控股士兰集科？还有作为一个营收百亿的半导体公司，有没有市值管理，市值已经让很多后起之秀追上了？</p> <p>回答：根据公司与厦门半导体签订的投资协议，士兰集科实现盈利满一年或投产满 7 年，公司可以通过向厦门半导体回购部分股权实现对士兰集科的控股。具体请阅读公司相关公告。</p> <p>问题 15：作为全球排行第六的半导体巨头和国产替代的先锋，我坚定看好贵公司的发展前景；但是从 2021 年到 2025 年，销售额翻了一倍；但是利润和 21 年比却没有什么增长，增收不增利；甚至在今年的大牛市中，上证指数涨了 18%；贵公司股价也只涨了 10%，一年一次涨停都没有，严重落后大盘；在贵公司盈利底部反转，各条线满线生产的情况下，出现这种情况投资者难以接受？请问贵公司有没有什么具体措施扭转增收不增利的局面？有没有什么具体措施进行市值管理以匹配全球排行第六的半导体巨头身份？</p>
--	---

	<p>回答：士兰微电子在多个产品领域已经取得了领先的优势，营收持续保持较快增长，但盈利增加不多，主要是因为现阶段研发投入、产能建设等维持较高水平，且当前功率半导体行业竞争比较激烈，产品价格压力较大。因此利润率持续提升还需要通过持续努力，前途是光明的。</p> <p>问题 16：在 OCS 的 MEMS 方案中，对微镜阵列的工艺和可靠性要求极高。公司凭借 IDM 一体化优势，在 MEMS 传感器领域已成功实现国产替代。请问这一优势能否复制到 OCS 所需的更高端 MEMS 器件上？</p> <p>回答：我们暂时没有开发微镜阵列的计划。</p>
--	---